SMILE40:長期気球実験に向けた MPPCシンチレーションカメラの開発

京都大学 齋藤要

谷森達,高田淳史,水村好貴,古村翔太郎,岸本哲朗,竹村泰斗,吉川慶, 中増勇真,中村優太,谷口幹幸,水本哲矢,園田真也,窪秀利,

黒澤俊介(東北大NICHe,山形大理),身内賢太朗(神戸大理),

澤野達哉(金沢大数物)

日次 MPPCシンチレーションカメラのシステム ^{装置} データ取得方法 FPGA評価ボードを用いての評価 FPGA V3基板を用いての評価



長期気球実験 SMILE-III に向けて

SMILE-III

南半球Super Pressure Balloon 観測時間: ~1ヶ月

COMPTELの5倍の感度で半球のサーベイ

- ・銀河面に広がる²⁶AI
- ・電子陽電子対消滅線の銀河面分布
 ・GRBの偏光観測 など







(2017年春の物理学会 中増講演)

本講演: • MPPC, AMP, Sampling ADC + FPGA評価ボード

システムとして問題なく動作しているか

•MPPC, AMP, Sampling ADC + FPGA V3基板

ノイズを抑えられているか

MPPC基板, AMP基板



8×8 unit

AMP基板







Sampling ADC









<mark>(HAPM-0.3PS)</mark> HV 217 V 温度 15℃

ベースラインのゆらぎの幅 ~28 mV (FWHM)

Sampling ADC + FPGA 評価結果 ^{137Csを置いて測定}





V1 → V3基板への改善点
 低ノイズのDC/DCに変更
 →電源ラインのノイズを低減



電源ライン(FPGA単体)



ノイズの最大要因の確認

MPPC, AMP, ADC基板にFPGA基板から 電源を供給するとノイズの影響を受ける







まとめ

・MPPC, AMP, Sampling ADC + FPGAで測定可能

	MPPC	MPPC, AMP, Sampling ADC +		
	FPGA 評価ボード (HV 217 V)	FPGA V3基板 (HV 215 V)	FPGA V3基板 (外部電源使用) (HV 217 V)	
ベースラインのゆらぎ	28 mV	100 mV	45 mV	
<i>∆E/E</i> (@662 keV)	10.2%	-	10.7%	

V3基板でノイズを抑えたことにより分解能が向上
 FPGA V1基板(外部電源使用(215 V))~14%

今後の方針

- ・電源とFPGA回路の分離
- ・波形をfittingすることにより波高値を求める

MPPC

S13361-3050NE-08



1	p	ixe
_	-	

pixel 数	64 (8 × 8)	
有効受光面積 / pixel	3 × 3 mm	
cell 数 / pixel	3584	
cell ピッチ	50 µm	
開口率	74 %	
感度波長範囲	320 ~ 900 nm	
最大感度波長	450 nm	
端子間容量 / pixel	320 pF	
降伏電圧 V _{BR}	$53 \pm 5 V$	
增幅率 (V _{OP} =V _{BR} +3 V, T=25 °C)	1.7×10^{6}	

MPPC 検出効率 vs. 波長

S13361-3050NE-08



(浜松ホトニクス)